



Gowin RiscV_AE350_SOC RDS 软件 发布说明

MRN1025-1.0, 2023-07-21

版权所有 © 2023 广东高云半导体科技股份有限公司

 GOWIN 高云、Gowin、GOWIN 以及高云均为广东高云半导体科技股份有限公司注册商标，本手册中提到的其他任何商标，其所有权利属其拥有者所有。未经本公司书面许可，任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责声明

本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止反言或其它方式授予任何知识产权许可。除高云半导体在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，高云半导体概不承担任何法律或非法律责任。高云半导体对高云半导体产品的销售和 / 或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。高云半导体对文档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任，高云半导体保留修改文档中任何内容的权利，恕不另行通知。高云半导体不承诺对这些文档进行适时的更新。

版本信息

日期	版本	描述
2023/07/21	1.0	初始版本。

目录

目录 i

1 关于发布 1

2 平台支持 3

3 文档..... 4

4 技术支持 5

1 关于发布

RiscV_AE350_SOC RDS V1.0 版本软件发布包括 RDS 软件的特征和增强功能，高云®半导体建议下载此版本以获得最新的软件改进。

功能和增强总述

软件发布功能项如下表：

特征	描述
RiscV_AE350_SOC RDS 软件：V1.0	
MCU 支持	● GOWIN-AE350 ● ADP-AE350-A25-GOWIN
新功能	● 运行、编辑、调试和配置 RiscV_AE350_SOC 目标系统源代码程序 ● LdSaG 文件编辑器 ● 代码覆盖率分析器 ● 国际标准插件程序 ● 性能分析器 ● 功能代码大小分析 ● 热键收集日志 ● 目标系统管理 ● MCU 配置文件编辑器 ● 系统内置程序编制 ● 系统外置 API 插件程序 ● 先进的程序调试系统 ● RTOS 程序调试系统 ● 工具链：编译器、汇编器、链接器、调试器和函数库 ● 仿真器：内核模拟仿真器 ● ICE：AICE MINI+调试器
增强	● 为最大限度使用 RISC-V 向量处理器，编译器支持 RISC-V 向量扩展的自动向量化

特征	描述
	● 编译器和工具链集成指令扩展功能 ● 支持 LLVM 工具链、模拟器和向量软件编程，开发者可以在模拟器中编制、编译和运行 RVV 应用程序 ● 支持 DSP 软件编程、Vector 软件编程和 NN 软件编程

2 平台支持

本次软件发布支持的平台有：

Windows	Windows 7/8/10/11 (64 bits)
---------	-----------------------------

3 文档

本次软件发布文档包含 RDS 软件的文档，PDF 文档已打包到安装目录下，文档列表如下：

文档	使用
MUG1026, Gowin RiscV AE350 SOC RDS 软件安装指南	PDF
MUG1025, Gowin RiscV AE350 SOC RDS 软件用户手册	PDF
MRN1025, Gowin RiscV_AE350_SOC RDS 软件发布说明	PDF

4 技术支持

高云半导体提供全方位技术支持，在使用过程中如有任何疑问或建议，可直接与公司联系：

网址：www.gowinsemi.com

E-mail: support@gowinsemi.com

Tel: 86 755 82620391

